

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国金证券、浙商证券、华创证券、信达澳亚、银华基金、太平养老基金、西部利得基金
时间	2023年11月
地点	现场参观和电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李大林
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1.公司简介和业务结构？</b></p> <p>甬矽电子（宁波）股份有限公司于2017年11月设立，位于中意宁波生态园区，公司主营业务为集成电路的封装与测试，并根据客户需求提供定制化的封装技术解决方案，在射频前端芯片封测、AP类SoC芯片封测、触控IC芯片封测、WiFi芯片封测、蓝牙芯片封测、MCU等物联网、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域具有良好的市场口碑和品牌知名度。公司被评为国家“集成电路重大项目企业名单”。</p> <p>从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，车间洁净等级、生产设备、产线布局、工艺路线、技术研发、业务团队、客户导入均以先进封装业务为导向，公司全部产品均为QFN/DFN、WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、FC-LGA等中高端先进封装形式，并在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒装产品（FC类产品）、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）等先进封装领域</p>

具有较为突出的工艺优势和技术先进性。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，公司获得了集成电路设计企业的广泛认可，并同众多国内外知名设计公司缔结良好的合作关系。

## **2.公司产品具体到下游应用领域的营收结构？**

公司 2023 年第三季度来自 PA 领域的营收表现良好，需求旺盛且不受某一家客户影响，整个行业需求较好。PA 线的产能稼动率较高，处于相对饱和状态，整体收入占比接近 20%。公司产品下游涉及多个领域，如 IoT 领域、TV 和无线通信领域等，受到部分客户新产品推出和市场扩大等因素的影响，营收有所增加；安防领域相对平稳，运算类和汽车类客户的占比仍较低。

## **3.公司今年的财务波动有些大，简述毛利率降低的原因？**

公司的毛利率取决于两个方面，一方面是订单的价格，这个最终取决于市场恢复的一个程度。另一方面，对于公司二期新增的投资，虽然公司的稼动率属于比较饱满状态，但产能存在一个爬坡的过程，同时为新增投资提前储备了生产端的人员以及水电能源等成本，对于公司的毛利率有一定的影响。随着公司营收规模的扩大，会摊掉更多的成本，对毛利率也有一定的正向提升作用。

## **4.行业的价格趋势？**

价格趋势需要根据具体的产品和客户的产品结构决定。目前整体来说价格处于一个相对稳定的状态，具体产品的价格变动需要根据客户的产品进行具体分析。

## **5.公司的资本开支情况？**

截止目前公司还没有制定明年具体的投资计划，预计在未来两年内投资规模仍较大，长期看扩产重点将放在 FC 和先进封装领域，具体金额预计将在四季度制定明年投资计划届

时在沟通交流。

**6.展望公司四季度和明年的营收情况？**

公司预计第四季度保持营收持续增长，维持全年逐季度营收持续增长的态势。

**7.在建工程有没有转固，后续折旧金额如何变化？**

从绝对金额上看，预计今年四个季度的折旧环比逐步上升。明年折旧的绝对金额预计仍会上涨，但相信随着营收规模的增长会摊薄。

**8.二期的投资能支撑公司实现多大的产能？**

产能情况一方面取决于市场需求的变化，同时跟产品结构和应用领域存在一定关系。另一方面，公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。

**9.公司在先进封装的布局？**

公司积极布局相关先进封装领域。通过实施 Bumping 项目掌握的 RDL 及凸点加工能力，为公司后续开展晶圆级封装、扇出式封装及 2.5D/3D 封装奠定了工艺基础。

**10.二期具体会投产哪些项目？**

公司二期布局主要包括 Bumping、晶圆级封装、倒装类产品以及部分车规、工规的产品线等。

**11.明年的盈利水平呢？费用能得到改善吗？**

公司盈利情况主要取决于两个方面，一方面是订单的价格，这个最终取决于市场恢复的一个程度。另一方面，对于公司二期新增的投资，产能存在一个爬坡的过程，同时为新增投资提前储备了生产端的人员以及水电能源等成本，对于公司的毛利率和费用支出有一定的影响。随着公司营收规模的扩大，会摊掉更多的成本，对盈利也有一定的正向提升作用。

**12.明年毛利率水平？**

2023 年第三季度整体毛利率为 16.92%，较第二季度环比提升 1.85%。影响毛利率的核心因素有两个，一个是稼动

率，另一个是价格，稼动率自二季度开始处于较高水平，从目前来看，价格处于相对稳定的状态，导入的新产品可能毛利率更高，随着公司第四季度的营收规模进一步扩大，以及一些新产品的导入，对于毛利率来说会形成正向的影响。

### **13.公司扩产幅度很大，有没有担心产能过剩？**

一方面，公司目前的客户主要以偏细分领域的龙头为主，在这些客户推出新产品的同时成为部分客户的一供，能随着客户的成长而成长；另一方面，在新客户的拓展上，随着二期产品线的构建、技术实力的持续提升，在新客户拓展取得了一定的进展，包含台湾地区的头部客户，一些大陆客户的份额深化，为公司未来在客户端奠定一定的基础。

### **14.公司目前的产能新增情况？WB类产能明年会持续增加吗？**

不同产品产能情况不同。Bumping是新产线，全部为新增产能，WB类产品的市场需求持续存在，公司将根据市场情况在原有的基础上继续增加产能。

### **15.现在Bumping还需要委外吗？公司的Bumping是8吋还是12吋？**

Bumping已通线量产，形成“Bumping+CP+FC+FT”的一站式封测平台，公司Bumping以12吋为主，有少量客户需要8吋也会匹配其需求。

### **16.Bumping对毛利率的影响？**

一方面，通过Bumping让公司具备了“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力，可以有效缩短客户从晶圆裸片到成品芯片的交付时间及更好的品质控制，客户可以更好的协调供应链，减少备货成本。另一方面，公司通过实施Bumping项目掌握的RDL及凸点加工能力，为公司后续开展晶圆级封装、扇出式封装及2.5D/3D封装奠定了工艺基础。因此，公司Bumping的量产将有利于公司的营收和

毛利率。

**17.公司产能的爬坡速度？**

产能情况一方面取决于市场需求的变化，同时跟产品结构和应用领域存在一定关系。另一方面，公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。

**18.公司二期后续还有什么投资规划吗？**

截止目前公司后续投资计划正在制定中，预计在未来两年内投资规模仍较大，长期看扩产重点将放在 FC 和先进封装领域。

**19.在建工程何时转固？**

公司第三季度已经开始转固，后续将按照验收的节奏陆续转固。转固和折旧的绝对金额会提升，但随着营收的扩大，相对比例可能会降低。

**20.从目前来看，股权激励的目标能达成吗？股权激励的费用怎么计提？**

股权激励目标是公司基于未来发展战略和自身经营目标所制定，公司将通过持续的技术研发和市场推广，提升自身竞争能力，为实现既定目标而努力。

**21.竞争激烈的情况会延续到明年吗？**

公司自身定位在先进封装领域，坚持大客户的策略，专注与高端、愿意承担一定成本的追求性能的客户合作，努力成为客户的一供和高端产品的差异化竞争，与客户共同成长。

**22.Pamid 需求如何？**

根据公司目前的观察，需求相对旺盛。

**23.CoWoS 进展？对应的生产设备都下单购买了吗？储备有相关客户吗？**

公司自成立以来专注于先进封装领域的技术创新和工艺改进，正积极布局 2.5D/3D 等先进封装领域，并与一些客户

	<p>保持密切交流。</p> <p><b>24.公司 IPO 的募集资金大概只有 10 亿，二期 110 亿投资的资金来源是？</b></p> <p>甬矽电子二期项目建设资金来源可分为自有资金、产业基金出资及银行贷款等债权融资。</p> <p><b>25.三季度营收创历史新高，简要说一下订单情况？</b></p> <p>公司 2023 年第三季度来自 PA 领域的营收表现良好，需求旺盛且不受某一家客户影响，整个行业需求较好。PA 线的产能稼动率较高，处于相对饱和状态，整体收入占比接近 20%。公司产品下游涉及多个领域，如 IoT 领域、TV 和无线通信领域等，受到部分客户新产品推出和市场扩大等因素的影响，营收有所增加；安防领域相对平稳，运算类和汽车类客户的占比仍较低。</p> <p><b>26.公司二期的项目进展？</b></p> <p>Bumping 通线量产，FC 也在进行扩产，具体后续项目进展以公开披露的信息为准。</p> <p><b>27.明年 Bumping 的产能、营收会单列出来吗？</b></p> <p>公司产品的具体披露方式请参阅届时的公开披露信息。</p> <p><b>28.Bumping 产线的保本点？</b></p> <p>公司重在打造 “Bumping+CP+FC+FT” 的大 turnkey 模式，会统筹考虑产品的盈利情况。</p> <p><b>29.测试环节的产能也在扩张吗？</b></p> <p>公司以封装驱动测试业务，封装产能扩大时测试产能也会相应增长，如公司重点打造的 “Bumping+CP+FC+FT” 的模式下 CP 产能也会增加。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 14 日